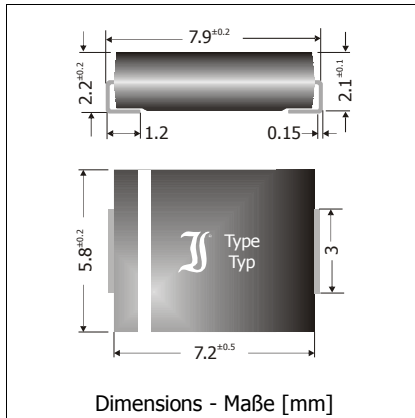


SK82 ... SK810

Surface Mount Schottky Rectifier Diodes Schottky-Gleichrichterdioden für die Oberflächenmontage

Version 2012-04-04



Nominal current – Nennstrom

8 A

Repetitive peak reverse voltage

20...100 V

Periodische Spitzensperrspannung

Plastic case

~ SMC

Kunststoffgehäuse

~ DO-214AB

Weight approx. – Gewicht ca.

0.21g

Plastic material has UL classification 94V-0

Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging taped and reeled

Standard Lieferform gegurtet auf Rolle



Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]	Forward voltage Durchlass-Spannung V_F [V] ¹⁾	
			$I_F = 5$ A	$I_F = 8$ A
SK82	20	20	< 0.50	< 0.55
SK83	30	30	< 0.50	< 0.55
SK84	40	40	< 0.50	< 0.55
SK85	50	50	< 0.63	< 0.70
SK86	60	60	< 0.63	< 0.70
SK88	80	80	< 0.77	< 0.85
SK810	100	100	< 0.77	< 0.85

Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last

 $T_T = 100^\circ\text{C}$ $T_T = 85^\circ\text{C}$ I_{FAV} 8 A ²⁾8 A ³⁾

Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom

 $f > 15$ Hz I_{FRM} 30 A ²⁾27 A ³⁾

Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen

 $T_A = 25^\circ\text{C}$ I_{FSM} 140/150 A ²⁾125/135 A ³⁾

Rating for fusing, $t < 10$ ms
Grenzlastintegral, $t < 10$ ms

 $T_A = 25^\circ\text{C}$ i^2t 100 A²s ²⁾78 A²s ³⁾

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur

 T_j

-50...+150°C

Storage temperature – Lagerungstemperatur

 T_s

-50...+150°C

1 $T_j = 25^\circ\text{C}$

2 SK82 ... SK86

3 SK88 ... SK810

Characteristics

Leakage current
Sperrstrom

$T_j = 25^\circ\text{C}$
 $T_j = 100^\circ\text{C}$

$V_R = V_{RRM}$
 $V_R = V_{RRM}$

I_R
 I_R

Kennwerte

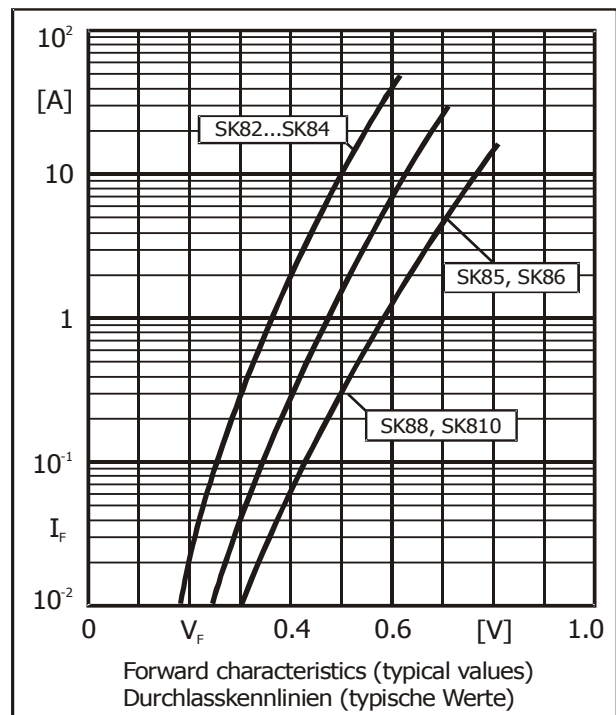
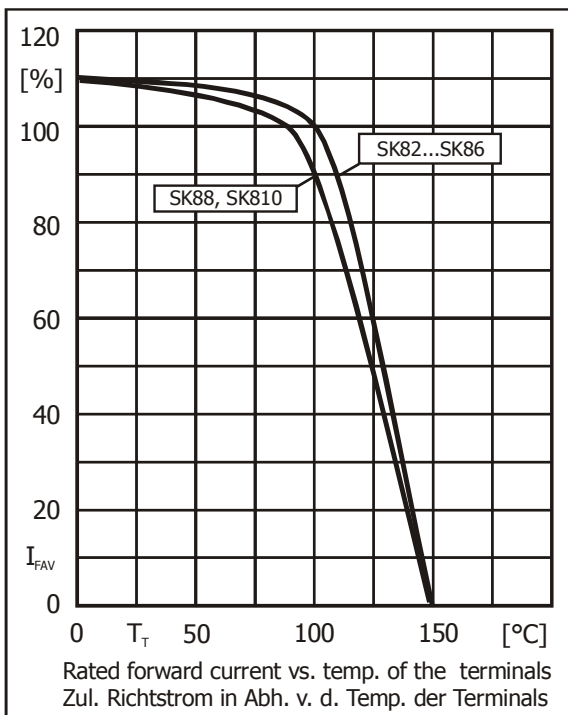
$< 200 \mu\text{A}$
 $< 20 \text{ mA}$

Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft

R_{thA} $< 40 \text{ K/W}^1$

Thermal resistance junction to terminal
Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss

R_{thT} $< 10 \text{ K/W}$



1 Mounted on P.C. board with 50 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 50 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss